

平成 29 年 12 月 6 日

各 位

上場会社名 双信電機株式会社
 代表者名 代表取締役社長 上岡 崇
 (コード番号 6938 東証第1部)
 問合せ先 経営推進本部経営企画室長 中西 港二
 (TEL 03-5730-4500)

連結子会社の固定資産売却および特別損失計上に関するお知らせ

当社の連結子会社である双信デバイス株式会社の固定資産の売却について、昨日、代表取締役社長が下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

また、売却に伴い特別損失を計上しますので併せてお知らせします。

記

1. 子会社の概要

(1)名称	双信デバイス株式会社
(2)所在地	宮崎県宮崎市高岡町小山田 13-4
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 下村泰之
(4)事業内容	セラミック多層製品、厚膜印刷基板の製造
(5)資本金	1 億円

2. 売却の理由

双信デバイス株式会社は、昨年度宮崎市内にある2工場を統合し、統合により使用しなくなった土地、建屋について、今後活用の見込みがないことから売却を決定しました。

3. 売却資産の内容

資産の名称及び所在地	資産の内容	売却価格	帳簿価格
双信デバイス株式会社宮崎工場 (宮崎県宮崎市高岡町内山字上ノ丸 271-2)	土地 6,997.14 m ² 建屋 1,161.43 m ²	総額 10 百万円	総額 64 百万円

4. 売却先の概要

(1)名称	有限会社成松工務店
(2)所在地	宮崎県宮崎市高岡町内山 259-1
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 成松和幸
(4)事業内容	建築工事、土木工事、増改築リフォーム
(5)資本金	23 百万円
(6)設立年月日	昭和 51 年 8 月 2 日
(7)純資産	61 百万円
(8)総資産	318 百万円

(9)大株主及び持株比率	成松和幸 32.4%、成松スエコ 29.3%、成松博利 15.1%
(10)当該会社との関係	売却先と当社および双信デバイス株式会社との間には、資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、関連当事者への該当状況に関し記載すべき事項はありません。

5. 売却の日程

不動産売買契約の締結日	平成 29 年 12 月 15 日(予定)
物件引渡し期日	平成 29 年 12 月 25 日(予定)

6. 特別損失

当該固定資産の売却により、平成 30 年3月期第3四半期において、売却に係る諸費用を含め約 60 百万円の特別損失を計上する予定です。

7. 今後の見通し

本売却については平成 29 年 10 月 31 日に公表した平成 30 年3月期の通期連結業績予想に織り込み済みであり、業績予想の修正はありません。

以 上